

平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年8月10日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社アバールデータ

コード番号 6918 URL <http://www.avaldata.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 嶋村 清

問合せ先責任者 (役職名) 管理本部部長

(氏名) 大関 拓夫

TEL 042-732-1000

四半期報告書提出予定日 平成24年8月10日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期第1四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期第1四半期	1,476	△22.6	80	△61.3	99	△58.5	49	△71.4
24年3月期第1四半期	1,907	16.8	207	149.8	238	102.4	173	78.6

(注) 包括利益 25年3月期第1四半期 △49百万円 (—%) 24年3月期第1四半期 136百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年3月期第1四半期	8.23	—
24年3月期第1四半期	29.09	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年3月期第1四半期	9,814	8,408	78.9
24年3月期	10,299	8,523	76.3

(参考) 自己資本 25年3月期第1四半期 7,741百万円 24年3月期 7,855百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年3月期	—	11.00	—	10.00	21.00
25年3月期	—	—	—	—	—
25年3月期(予想)	—	8.00	—	10.00	18.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成25年 3月期の連結業績予想(平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	3,100	△7.5	225	△17.2	240	△21.9	150	△35.5	24.94
通期	6,550	0.0	550	4.3	580	△0.7	365	△10.3	60.70

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 ― 社 (社名) 、 除外 ― 社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- | | |
|----------------------|-----|
| ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 有 |
| ② ①以外の会計方針の変更 | : 無 |
| ③ 会計上の見積りの変更 | : 有 |
| ④ 修正再表示 | : 無 |

(注)第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、【添付資料】3ページ「2. サマリー情報(その他)」に関する事項「(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	25年3月期1Q	8,064,542 株	24年3月期	8,064,542 株
② 期末自己株式数	25年3月期1Q	2,048,704 株	24年3月期	2,055,804 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年3月期1Q	6,013,497 株	24年3月期1Q	5,952,704 株

(注)当社は、信託型従業員持株インセンティブ・プランを導入しております。当該プランにかかる信託口が所有する当社株式数については、四半期連結財務諸表において自己株式として表示していることから、当該信託口が所有する当社株式数については、25年3月期1Qの「期末自己株式数」に248,300株、24年3月期に255,400株をそれぞれ含めており、「期中平均株式数(四半期累計)」から25年3月期1Qは250,641株、24年3月期に282,088株を控除しております。なお、信託型従業員持株インセンティブ・プランの詳細については【添付資料】4ページ(3) 追加情報に記載しております。

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
(3) 追加情報	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
四半期連結損益計算書	7
四半期連結包括利益計算書	8
(3) 継続企業の前提に関する注記	9
(4) セグメント情報	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10
4. 補足情報	10
(1) 生産、受注及び販売の状況	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要などにより穏やかに回復しつつあるものの、欧州財政危機を背景とした世界経済の減速や円高の長期化など、景気の先行きについては依然として不透明な状況が続いております。

当社グループに関連深い半導体製造装置業界におきましては、世界経済の先行き不透明感による設備投資の抑制により、当第1四半期は調整局面が続いており、半導体製造装置関連製品の需要が減少しております。

このような経営環境のもと、当社グループは顧客満足度の更なる向上のために、高性能化と利便性を追求した新製品の投入によりお客様の装置の進化に貢献するとともに、生産設備の最適化を図り、さらなる省力化と生産性向上で環境に優しいモノ作りを実現、品質面では業界水準を越える品質の確保、さらに社内業務のシンプル化により、収益性の改善に取り組みました。

この結果、第1四半期連結累計期間における売上高は1,476百万円（前年同四半期比22.6%減）、営業利益は80百万円（前年同四半期比61.3%減）、経常利益は99百万円（前年同四半期比58.5%減）、四半期純利益は49百万円（前年同四半期比71.4%減）となりました。

当社グループでは、事業内容を2つの報告セグメントに分けております。当第1四半期連結累計期間におけるセグメント別の状況は次のとおりであります。

① 受託製品

当該セグメントは、半導体製造装置関連、産業用制御機器及び計測機器の開発・製造・販売を行っております。計測機器が好調に推移しましたが、大手半導体メーカーの設備投資は回復に至っておらず、売上高は大幅に減少しております。

この結果、売上高は909百万円（前年同四半期比31.6%減）、セグメント営業利益は124百万円（前年同四半期比43.6%減）となりました。

当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。

イ) 半導体製造装置関連

当該品目は、半導体製造装置の制御部を提供しております。大手半導体メーカーのLSI微細化が続く中、最先端の半導体製造装置への設備投資が一部で再開されましたが、半導体製造装置関連製品全体の回復に至っておらず、売上高は大幅に減少いたしました。

この結果、売上高は507百万円（前年同四半期比48.1%減）となりました。

ロ) 産業用制御機器

当該品目は、各種の産業用装置、社会インフラ関連の制御部の開発・製造を行いカスタマイズ製品として提供しております。産業用装置の受注は堅調に推移しましたが、社会インフラ関連が引続き低迷し、売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は170百万円（前年同四半期比2.5%減）となりました。

ハ) 計測機器

当該品目は、各種計測機器のコントローラ、通信機器の制御部の開発・製造を行いカスタマイズ製品として提供しております。主力の電力関連機器全般が堅調であることに加え、各種計測機器の受注が好調に推移し、売上高は大幅に増加いたしました。

この結果、売上高は230百万円（前年同四半期比31.1%増）となりました。

② 自社製品

当該セグメントは、組込みモジュール、画像処理モジュールおよび計測通信機器の開発・製造・販売並びにこれらに付属する周辺機器およびソフトウェア等の自社製品関連商品の販売を行っております。計測通信機器が好調に推移いたしましたが、組込みモジュールの受注が減少したため、売上高は減少しております。

この結果、売上高は567百万円（前年同四半期比1.9%減）、セグメント営業利益は84百万円（前年同四半期比29.1%減）となりました。

当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。

イ) 組込みモジュール

当該品目は、半導体製造装置、FA全般、電力・通信関連向けに提供しております。FA全般および半導体製造装置関連の受注が減少したため、売上高は大幅に減少いたしました。

この結果、売上高は113百万円（前年同四半期比41.0%減）となりました。

ロ) 画像処理モジュール

当該品目は、FA 全般、各種検査装置、液晶関連機器に提供しております。新製品の立ち上がりに加え新分野での営業開拓が順調に進みましたが、FA 全般および液晶関連装置が

低迷いたしました。

この結果、売上高は170百万円（前年同四半期比5.6%減）となりました。

ハ) 計測通信機器

当該品目は、超高速シリアル通信モジュール「GiGA CHANNEL」シリーズ、FAXサーバ・コールセンター向けCTI（Computer Telephony Integration）・リモート監視機器およびスマート電源装置を提供しております。超高速シリアル通信モジュールにおいては新製品の開拓が大きく貢献し、CTIおよびリモート監視機器が好調に推移したことに加え、新規事業であるスマート電源装置の貢献により、売上高は大幅に増加いたしました。

この結果、売上高は259百万円（前年同四半期比61.2%増）となりました。

ニ) 自社製品関連商品

当該品目は、自社製品の販売促進とシステム販売による高付加価値化を図るため、ソフトウェアおよび付属の周辺機器を提供しております。大口受注の減少により、売上高は大幅に減少いたしました。

この結果、売上高は24百万円（前年同四半期比45.1%減）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における資産は9,814百万円（前連結会計年度末比484百万円の減少）となりました。

流動資産につきましては、主に、現金及び預金が90百万円増加、受取手形及び売掛金が263百万円減少、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品これらのたな卸資産が126百万円減少、その他が繰延税金資産の減少並びに未収入金及び前払費用等の増加により7百万円減少した結果、306百万円減少し6,161百万円となりました。固定資産につきましては、主に、有形固定資産が16百万円減少、無形固定資産が4百万円増加、投資その他の資産が投資有価証券の時価変動等の影響により166百万円減少した結果、178百万円減少し3,653百万円となりました。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における負債は1,406百万円（前連結会計年度末比370百万円の減少）となりました。

流動負債につきましては、主に、原材料等の仕入減少に伴い支払手形及び買掛金が123百万円減少、未払法人税等が136百万円減少、賞与引当金が70百万円減少、役員賞与引当金が11百万円減少、その他が預り金及び未払費用の増加並びに未払金及び前受金等の減少により29百万円増加した結果、312百万円減少し869百万円となりました。固定負債につきましては、主に、その他が繰延税金負債の減少等により59百万円減少した結果、57百万円減少し537百万円となりました。

なお、負債項目に記載しております、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」導入によるものであります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産は8,408百万円（前連結会計年度末比114百万円の減少）となりました。

主に、利益剰余金が13百万円減少、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」導入により自己株式が4百万円減少、その他有価証券評価差額金が105百万円減少したことが要因となります。

(自己資本比率)

当第1四半期連結会計期間末における自己資本比率は78.9%（前連結会計年度末比2.6ポイントの増加）となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

当社グループに関連の深い半導体製造装置業界は、当初の予想より市況環境や需要環境の回復が遅れており予断を許しませんが、現時点では平成24年5月11日付「平成24年3月期 決算短信」に公表いたしました数値からの変更はございません。

また今後、当社グループを取り巻く環境が著しく変化した場合等、業績に影響を及ぼす事態が生じた場合には速やかに適時開示を行います。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はございません。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成24

年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更による当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

(3) 追加情報

(信託型従業員持株インセンティブ・プランの会計処理について)

当社は、平成23年5月25日開催の取締役会において、当社グループ従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」（以下「本プラン」といいます。）の導入を決議いたしました。

割当先である野村信託銀行株式会社「アパールグループ社員持株会専用信託口」（以下「従持信託」といいます。）は、当社と野村信託銀行株式会社の間で、当社を委託者、野村信託銀行株式会社を受託者とする金銭信託契約（以下「本信託契約」といい、本信託契約によって設定される信託を「本信託」といいます。）を締結することによって設定された信託口であります。

本プランでは、従持信託が、本信託の設定後6年間にわたりアパールグループ社員持株会（以下「本持株会」といいます。）が取得すると合理的に見込まれる数の株式会社アパールデータ株式を、金融機関からの借入金を原資として、当社からの第三者割当によって取得します。当該借入は、貸付人を株式会社横浜銀行、借入人を従持信託、保証人を当社とする三者間で締結される責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づいて行われます。

従持信託が取得した当社株式は、本持株会と締結される株式注文契約に基づき、信託期間（6年）において、毎月、その時々々の時価で売却いたします。

本信託では、当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を借入金の返済及び金利の支払いに充当いたします。本信託の終了後、本信託の信託財産に属する金銭から、本信託に係る信託費用や未払いの借入元利金などを支払い、残余の財産が存在する場合は、当該金銭を、本信託契約で定める受益者適格要件を満たす従業員等に分配いたします。なお、当社は従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落等により本信託の終了時点において借入金が完済できない場合は、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき保証人である当社が保証履行いたします。

当社は平成23年6月22日付で、自己株式312,400株を従持信託へ譲渡しております。当該自己株式については、当社から従持信託へ株式を譲渡した時点で売却処理を行っております。また、従持信託が所有する株式を含む資産及び負債ならびに費用及び収益については、当社と従持信託は一体であるとし、当社の四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書に含めて処理しております。なお、従持信託が所有する株式については自己株式として表示しており、当第1四半期連結会計期間末において、従持信託が所有する当社株式数は、248,300株となっております。

3. 四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,041,801	3,132,781
受取手形及び売掛金	1,355,416	1,091,720
有価証券	10,157	10,159
商品及び製品	471,106	455,451
仕掛品	310,301	251,427
原材料及び貯蔵品	737,321	684,990
その他	541,928	534,604
流動資産合計	6,468,033	6,161,134
固定資産		
有形固定資産		
土地	1,316,699	1,316,699
その他(純額)	937,399	921,210
有形固定資産合計	2,254,099	2,237,910
無形固定資産	53,506	57,760
投資その他の資産		
投資有価証券	1,446,059	1,280,474
その他	108,595	108,065
貸倒引当金	△30,403	△30,363
投資その他の資産合計	1,524,251	1,358,176
固定資産合計	3,831,857	3,653,847
資産合計	10,299,890	9,814,981
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	593,846	470,684
1年内返済予定の長期借入金	38,000	38,000
未払法人税等	151,877	15,148
賞与引当金	197,570	126,756
役員賞与引当金	15,286	3,311
その他	185,811	215,598
流動負債合計	1,182,391	869,499
固定負債		
長期借入金	130,670	130,670
退職給付引当金	98,377	100,405
役員退職慰労引当金	70,672	70,672
その他	294,777	235,512
固定負債合計	594,496	537,259
負債合計	1,776,887	1,406,759

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,354,094	2,354,094
資本剰余金	2,446,534	2,446,534
利益剰余金	3,828,863	3,815,731
自己株式	△1,374,815	△1,370,257
株主資本合計	7,254,677	7,246,103
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	601,097	495,267
その他の包括利益累計額合計	601,097	495,267
少数株主持分	667,228	666,851
純資産合計	8,523,003	8,408,222
負債純資産合計	10,299,890	9,814,981

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)
売上高	1,907,345	1,476,944
売上原価	1,279,122	966,679
売上総利益	628,222	510,265
販売費及び一般管理費	420,750	429,991
営業利益	207,471	80,273
営業外収益		
受取利息	365	271
受取配当金	28,795	14,830
その他	2,105	4,084
営業外収益合計	31,266	19,187
営業外費用		
支払利息	—	311
為替差損	0	0
支払手数料	16	32
営業外費用合計	16	344
経常利益	238,721	99,115
特別利益		
投資有価証券売却益	15,123	—
特別利益合計	15,123	—
特別損失		
固定資産売却損	15	—
固定資産除却損	—	6
投資有価証券評価損	—	10,220
特別損失合計	15	10,226
税金等調整前四半期純利益	253,828	88,889
法人税、住民税及び事業税	74,766	11,102
法人税等調整額	7,622	21,904
法人税等合計	82,389	33,006
少数株主損益調整前四半期純利益	171,439	55,882
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△1,716	6,373
四半期純利益	173,155	49,508

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	171,439	55,882
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△35,324	△105,829
その他の包括利益合計	△35,324	△105,829
四半期包括利益	136,115	△49,947
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	137,831	△56,320
少数株主に係る四半期包括利益	△1,716	6,373

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第1四半期連結累計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日）

該当事項はありません。

(4)セグメント情報

I 前第1四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日）

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	受託製品	自社製品	合計
売上高			
外部顧客への売上高	1,328,795	578,550	1,907,345
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	1,328,795	578,550	1,907,345
セグメント利益	220,291	118,683	338,974

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利 益	金 額
報告セグメント計	338,974
セグメント間取引消去	—
全社費用（注）	△131,503
四半期連結損益計算書の営業利益	207,471

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

II 当第1四半期連結累計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日）

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	受託製品	自社製品	合計
売上高			
外部顧客への売上高	909,114	567,829	1,476,944
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	909,114	567,829	1,476,944
セグメント利益	124,223	84,123	208,347

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利 益	金 額
報告セグメント計	208,347
セグメント間取引消去	—
全社費用（注）	△128,073
四半期連結損益計算書の営業利益	80,273

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第1四半期連結累計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日）

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	722,765	19.2	363,644	△49.7
産業用制御機器	122,690	△36.6	127,176	3.7
計測機器	139,590	27.3	167,573	20.0
小計	985,046	8.3	658,394	△33.2
自社製品				
組込みモジュール	111,012	20.7	73,281	△34.0
画像処理モジュール	83,195	39.0	75,912	△8.8
計測通信機器	72,207	39.7	112,734	56.1
小計	266,414	30.9	261,928	△1.7
合計	1,251,461	12.4	920,322	△26.5

(注) 1 金額は製造原価にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3 自社製品セグメントにおいては、記載した詳細品目に付属する周辺機器の提供として、自社製品関連商品の販売を行っておりますが、当該仕入実績は、② 商品仕入実績として別途記載しております。

② 商品仕入実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
自社製品				
自社製品関連商品	35,534	25.3	30,701	△13.6
合計	35,534	25.3	30,701	△13.6

(注) 1 金額は仕入価格にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

③ 受注状況及び販売状況

イ) 受注高

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	842,451	7.7	448,733	△46.7
産業用制御機器	227,568	1.8	181,287	△20.3
計測機器	206,132	54.8	201,522	△2.2
小計	1,276,152	12.0	831,542	△34.8
合計	1,276,152	12.0	831,542	△34.8

ロ) 受注残高

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	332,501	△20.7	159,975	△51.9
産業用制御機器	209,439	△12.8	181,791	△13.2
計測機器	177,314	43.0	202,584	14.3
小計	719,255	△8.2	544,352	△24.3
合計	719,255	△8.2	544,352	△24.3

ハ) 販売実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	977,569	17.9	507,470	△48.1
産業用制御機器	175,212	△16.6	170,850	△2.5
計測機器	176,013	22.6	230,793	31.1
小計	1,328,795	12.3	909,114	△31.6
自社製品				
組込みモジュール	193,016	21.5	113,901	△41.0
画像処理モジュール	180,189	28.8	170,182	△5.6
計測通信機器	160,879	28.9	259,357	61.2
自社製品関連商品	44,464	70.4	24,388	△45.1
小計	578,550	28.7	567,829	△1.9
合計	1,907,345	16.8	1,476,944	△22.6

(注) 1 金額は販売価格にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3 受注高及び受注残高は受託製品セグメントの内容であり、自社製品セグメントにおいては、需要予測に基づき見込生産を行っているため、該当事項はありません。